

セミナー申込書

R&D 支援センターセミナー

「フィルム・包装のヒートシール技術【東京開催】」

開催日時：2026年3月25日（水）10:30～16:30

会 場：江東区産業会館 第2会議室

受 講 料：55,000 円（税込、テキスト付）

送信先 Fax：03-3291-5789

CMC リサーチ TEL：03-3293-7053

お名前 例) 山田 太郎	
フリガナ 例) ヤマダ タロウ	
法人名・会社名	
部署名	
郵便番号	
都道府県	
住所1 市区町村、番地等	
住 所2 アパート・マンション名、部 屋番号等	
メールアドレス	
電話番号	
FAX 番号	
メルマガ受信可否	<input type="checkbox"/> 受信する <input type="checkbox"/> 受信しない
DM（郵便など）受け取り 可否	<input type="checkbox"/> 受け取る <input type="checkbox"/> 受け取らない
興味分野	
お支払い（銀行振込） 予 定 日	年 月 日頃
通 信 欄	